

## NEWS RELEASE

半導体製造プロセスの基幹材料である CMP スラリーなどの生産能力を大幅向上  
台湾に最先端半導体材料の工場を新設  
既存工場の設備増強も実施、総額約 150 億円

2023 年 5 月 16 日

富士フイルム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：後藤 禎一）は、電子材料事業をさらに拡大するため、台湾に最先端半導体材料の工場を新設します。今回、半導体材料の台湾現地法人であるFUJIFILM Electronic Materials Taiwan Co., Ltd.（本社：台湾新竹市、総経理：Alex Chang、以下 FETW）が、台湾新竹市に新たな土地を取得し、CMP スラリー<sup>\*1</sup>やフォトリソ周辺材料<sup>\*2</sup>を生産する新工場を建設。2026 年春に稼働させる予定です。

また、台南市にある既存工場（台湾第 3 工場）でも設備増強を実施。建設中の新棟に CMP スラリーの製造設備などを導入し、2024 年春に稼働させる計画です。尚、新工場の建設と既存工場への設備増強をあわせた設備投資額は、約 150 億円<sup>\*3</sup>です。

半導体は、5G/6G による通信の高速・大容量化、自動運転の拡大、メタバースの普及などを背景に、年率約 10%<sup>\*4</sup>の市場成長と高性能化の進展が見込まれています。

富士フイルムは、フォトレジスト<sup>\*5</sup>やフォトリソ周辺材料、CMP スラリー、ポスト CMP クリーナー<sup>\*6</sup>、薄膜形成材<sup>\*7</sup>、ポリイミド<sup>\*8</sup>など半導体製造の前工程から後工程までのプロセス材料、イメージセンサー用カラーフィルター材料をはじめとした Wave Control Mosaic (WCM)<sup>\*9</sup>を展開しています。また、これらの幅広い製品のみならず、グローバルな安定供給体制や高い研究開発力、顧客との強固な信頼関係を生かして、事業拡大を進めています。現在、CMP スラリーの生産設備の導入（日本）やポリイミドの製造設備の増強（ベルギー）など国内外で積極的な設備増強を行い、半導体の需要増への対応を進めています。

今回、FETW は、急成長する台湾の半導体市場に対して製品供給能力を拡大するため、新竹市に土地を新たに取得し、最先端半導体材料の新工場を建設します。新工場では、最新鋭の製造設備や品質評価機器を導入し、CMP スラリーやフォトリソ周辺材料の現地生産体制と技術サポート体制を強化。製品倉庫も設置して、顧客要望にきめ細かく対応できるデリバリー体制を構築します。また、太陽光発電パネルを導入し、環境負荷の低減にも取り組むとともに、近接する台湾第 1・第 2 工場のオフィス機能を新工場に統合し、工場間の連携強化を図っていきます。

台南市にある台湾第 3 工場では、建設中の新棟に CMP スラリーの製造設備などを導入します。新工場の建設と既存工場への設備増強で、CMP スラリーなどの大幅な生産能力拡大を図り、半導体の需要伸長と現地の迅速供給へのニーズに応えていきます。

今後、台湾では、新工場を加えた 4 拠点の生産体制の下、高い品質基準を満たす製品のタイムリーかつ安定的な供給を図るとともに、伸長が予想される半導体需要を先取りする投資で現地の生産・開発・品質保証体制をさらに強化していきます。尚、今回の新工場の建設や既存工場への設備増強に伴い、約 50 名の新規雇用を計画しています。

富士フィルムは、積極的な設備投資などにより事業成長を加速させ、2030 年度には電子材料事業で 5,000 億円の売上を目指します。今後も、最先端半導体材料の開発・提供を通じて、半導体業界の発展に貢献していきます。

- ※1 硬さの異なる配線や絶縁膜が混在する半導体表面を均一に平坦化する研磨剤。CMP は、Chemical Mechanical Polishing（化学的機械研磨）の略。
- ※2 半導体製造のフォトリソ工程で使用する現像液やクリーナーなど。
- ※3 進行中の新棟の建設費用を含む。
- ※4 当社調べ。
- ※5 半導体製造の工程で、回路パターンの描画を行う際にウエハー上に塗布する材料。
- ※6 CMP スラリーによる研磨後に、金属表面を保護しながら、粒子、微量金属および有機残留物を洗浄するクリーナー。
- ※7 低誘電率の絶縁膜を形成するための材料。
- ※8 高い耐熱性や絶縁性を持つ材料。半導体の保護膜や再配線層の形成に使用される。
- ※9 広範囲な波長の電磁波(光)をコントロールする機能性材料群の総称。デジタルカメラやスマートフォンに用いられる CMOS センサーなどのイメージセンサーのカラーフィルターを製造するための着色感光材料を含む。

## 【設備投資の概要】

### (1) 新竹市の新工場

1.	場所	台湾国新竹市湖口工業団地
2.	主な投資内容	・ 製造・倉庫・オフィス機能を備えた新工場の建設 ・ CMP スラリーやフォトリソ周辺材料の製造設備や品質評価機器の導入 ・ 工場敷地内への太陽光発電パネルの設置
3.	着工時期	2024 年春
4.	稼働開始時期	2026 年春

### (2) 台南市の既存工場（台湾第 3 工場）

1.	場所	台湾国台南市善化區南部科學園區
2.	主な投資内容	・ 新棟の建設 ・ CMP スラリーや現像液の製造設備や品質評価機器の導入
3.	着工時期	2022 年 9 月
4.	稼働開始時期	2024 年春

本件に関するお問い合わせは下記にお願い致します

#### 【報道関係】

富士フィルムホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報グループ  
TEL 03-6271-2000

#### 【その他】

富士フィルム株式会社 エレクトロニクスマテリアルズ事業部 TEL 045-534-8824